

機器利用技術講習会のご案内

【高速シリコンディープエッチング装置】

当研究所では、公益財団法人 JKA の平成27年度公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業により「高速シリコンディープエッチング装置」を導入しました。この装置は、MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) デバイスの作製に良く使われます。この度、H29年度 JKA 人材育成等補助事業により、高速シリコンディープエッチング装置を用いた MEMS 加工を広く普及することを目的として、本装置の機器利用技術講習会を下記の要領で開催いたしますので、ご案内申し上げます。

◆日 時： 平成29年9月26日 (火)

① 9:45~11:45

② 13:15~15:15

※①, ②とも同じ内容の講習を行います。ご希望の時間帯をお選び下さい。

(バスでお越しの場合、①9:27 ②13:00 に和泉中央駅を出発するバスで間に合います。)

○当研究所内に食堂がございます。一般の方もご利用になれます。(営業時間：11:45~13:15)

◆場 所：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター (和泉市あゆみ野2-7-1)

当日は、講習開始時刻までに当研究所の玄関ホール 講習会受付にて、受付をお済ませください。担当者が講習会場にご案内します。(受付は講習会開始時間の10分前より始めます。)

◆定 員：各コース(①、②)3名。

※ 受講票は発行いたしません。返信で受付をお知らせします。

※ 受講には顧客登録カード(Kカード)が必要です。まだお持ちでない方は、申込み方法をご連絡いたします。

◆費 用：無料

◆申込み先：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター 顧客サービス部

※ お申込みは、メール (fukyu@tri-osaka.jp) またはFAX (0725-51-2520) でお願います。

※ 当研究所の催事情報等をお知らせする「ORIST EXPRESS 和泉センター版(メールニュース)」の配信をご希望のかたは、申込書にメールアドレスをご記入ください。

◆対象機器：高速シリコンディープエッチング装置

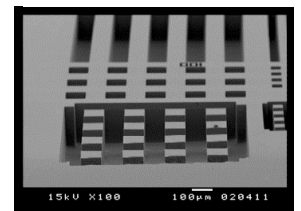
H29年度JKA人材育成等補助事業により高速シリコンディープエッチング(DRIE)装置MUC-21ASE-SRE (SPPテクノロジーズ株式会社)を用いた初心者向けの講習を開催します。本講習では、機器の概要説明を行った後、装置の操作方法を説明しながら、実習用のサンプルを実際に加工いたします。その後、走査電子顕微鏡JSM-5310(日本電子株式会社)で形状観察します。尚、本講習会では、受講者による持ち込み試料の対応はいたしません。



機器型番：
MUC-21 ASE-SRE
(SPP テクノロジーズ株式会社)



機器型番：
JSM-5310
(日本電子株式会社)



シリコン基板の加工例

◆講習担当：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター

電子・機械システム研究部 田中恒久, 村上修一, 佐藤和郎

・お問い合わせ先：顧客サービス部 TEL：0725-51-2518

